

「エレクトロニクス実装学会誌」執筆例(本文ファイル) :

中村 健次, 若林 信一, 前原 隆: “電解めっきによるバンプ成長過程の解析,” エレクトロニクス実装学会誌, Vol. 1, No. 1, pp. 41-46, Apr, 1998 を例として入れております。

和文タイトル :

電解めっきによるバンプ成長過程の解析

英文タイトル :

The Analysis of the Electroplating Bumps Formation

概要(300字以内。本文が日本語の場合、速報論文・技術報告は不要) :

電解めっきを～～。

ABSTRACT(100～150語以内。速報論文・技術報告は100語以内でも可) :

In order to ～～。

Key Words(英文で5つ程度。半角セミコロンで区切ってください) :

Bump; Additive Method; Electroplating

※システムでは6つ以上登録できないため、2つの単語の間を空白で区切るなどの対応をお願いします。

著者情報(お名前, 所属, 所属先住所) :

中村 健次 1, 若林 信一 1, 前原 隆 1

Kenji NAKAMURA 1, Shinichi WAKABAYASHI 1 and Takashi MAEHARA 1

1 新光電気工業株式会社開発統轄部プロセス開発部 (〒380-0921 長野県 長野市栗田 711)

1 Research & Development Div., Reserch & Development Dept., Shinko Electric Industries Co., Ltd. (711 Kurita, Nagano-shi, Nagano 380-0921)

2(別の所属の方がいらっしゃる場合、番号で区別してください)

責任著者(Corresponding Author)情報

(氏名)○○ ○○

(E-mail) xxxxx@xxx. xx. xx

※Corresponding Author は1名です。氏名をお知らせください(必須)。

※E-mail は任意です。E-mail アドレスを記載いただいた場合、誌面に掲載いたします(2021年以降)。

本文(「エレクトロニクス実装学会誌」原稿執筆の手引きをご確認ください) :

1. 緒言

半導体デバイスの高性能化,小型化に伴い,...(略)...量産性に優れている 1)～5)。 ～～

・図表は別ページ(別ファイルも可)にご作成ください。

文献

1)～～

(論文)

3) H.Watanabe and H.Honma : “Fabrication of nickel microbump on aluminum using electroless nickel plating,” J.Electrochem.Soc., Vol.144, No.2, pp. 471-476, Feb. 1997

4) 渡辺秀人, 本間英美: “マイクロバンプ形成とめっき,” 表面技術, Vol. 46, No. 9, pp. 775-777, Sep. 1995

(資料等)

7) 中村健次, 若林信一, 前原隆: “電解めっきによるバンプ成長過程の解析,” 第 11 回回路実装学術講演大会講演論文集, p. 241, 1997

8) 金属表面技術協会編: “金属表面技術便覧,” p. 279, 1976

著者紹介

(別ファイルも可。写真の掲載を希望しない, または著者紹介の掲載を希望しない場合はその旨をご記入ください)

なかむらけんじ, わかばやししんいち, まえはらたかし

著者紹介の掲載を希望しない場合も, 著者名のかな表記を最後にご記入ください。

※日本人以外の著者の方はカタカナで, 姓名等の区切りがわかるようにご記入ください。